

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2020〕第 148 号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提出的问题，公司积极组织相关人员进行逐项落实和核查，现对所涉及的事项逐一回复如下：

近日，你公司在互动易回复称，公司注重宇航电子科研、生产、测试等方面基础条件的建设，先后建成了集成电路 EDA 设计平台、SIP 立体封装数字化生产线、SOC 陶瓷封装生产线、数字化电装生产线、SOC 芯片自动化测试平台、SIP 自动化测试平台等。多名投资者就相关情况进行了提问，请你公司补充说明以下事项：

1. 请补充说明你公司建成的 EDA 设计平台包含的具体内容、建成的时间、投资的金额、可实现的功能、实际使用情况和效果，相关平台是否具备完全的自主知识产权和独立运作的的能力，是否具有通用性或可向第三方销售。

公司回复：

公司集成电路 EDA 设计平台主要包括硬件设计平台、软件设计平台及芯片验证平台三个部分。其中硬件设计平台主要包括用于设计的高性能运算服务器，管理服务器及登录终端等；软件设计平台包括：IP 核、专用设计库、设计输入软件、设计仿真软件、设计综合软件、设计验证软件等；芯片验证平台包括：专用测试软件、测试设备、测试机台等，服务于 SOC、通信总线、SIP、人工智能芯片等产品的验证。

公司集成电路 EDA 设计平台从 2003 年开始建设，并配合公司的研发工作逐步完善，可实现芯片设计、仿真、测试、验证等功能，满足公司业务需求。整个

平台的投资总额约 2300 万元，目前使用状态良好。

公司通过使用该 EDA 设计平台先后成功开发出了 SPARC V8 单核系列处理器 SOC 芯片 S698-T、S698-MIL 等，SPARC V8 多核系列处理器 SOC 芯片 S698PM、S698P4 等，以及 1553B、ARINC429 等通信接口芯片。

该平台通过购买、自研相结合的方式建设完成；购买的部分包括：设计输入软件、仿真软件、信号分析软件及功耗分析软件，用于芯片的设计、仿真及分析验证；自研的部分主要集中在验证平台，具有自主知识产权，属于定制化设计。

公司集成电路 EDA 设计平台建设主要满足公司自己内部的研发使用需求，不对外销售。

2. 你公司前期披露的公告显示，公司高性能嵌入式人工智能芯片等项目具体的开发工作交由外部单位进行，2019 年你公司符合资本化条件的研发项目中，委外设计和开发金额占研发投入资本化金额的 94%。请补充说明大量委外设计和开发是否符合公司所在行业惯例以及公司是否具备独立的研发能力和主要产品生产能力，公司开发的人工智能芯片的具体应用领域、实现收入情况或预计实现收入的时间，并就相关业务开展中存在的风险进行充分提示。

公司回复：

公司高性能嵌入式人工智能芯片项目并非完全委外设计，而是采用合作开发的方式，即芯片的产品调研、产品定义、前期预研、芯片前端设计以及部分仿真验证均由公司自主完成，而芯片后端设计、芯片封装设计、芯片生产等主要是委托第三方完成。该芯片项目于 2018 年启动，先后投入了约 1000 万元的研发支出并于当期予以费用化，主要进行了项目前期调研、项目需求分析、项目可行性分析、技术摸底和技术预研工作，技术预研工作包括：嵌入式 AI 系统仿真验证平台的研制、人工智能芯片关键 AI 模块仿真验证等。预研过程中解决了多个关键问题，突破核心技术壁垒，为后续研发奠定基础。上述前期工作完成后，项目基本不存在重大的技术障碍，2019 年项目开始进入开发实施阶段，故 2019 年开始将相关开发支出按照会计准则的相关规定进行资本化处理。

芯片行业的产业链较长，合作分工是行业内的通行惯例。一般情况下，芯片设计公司负责完成芯片的前、后端设计，甚至仅需完成芯片的前端设计，后续的

芯片流片、芯片封装交由第三方完成。公司之前成功研发的项目（例如：SPARC V8 系列处理器 SOC 芯片）均系按照该模式完成，芯片项目的成本主要为包含在委外支出的 IP 购买、芯片流片、芯片封装等费用。因此，公司高性能嵌入式人工智能芯片项目的开发符合行业惯例。

公司深耕航空航天领域近二十年，致力于嵌入式 SOC 处理器芯片、SIP 立体封装模块/系统、EMBC 宇航总线控制系统的研制、设计、生产和销售，是国内首家设计出 SPARC V8 架构处理器芯片的公司，率先推出了基于 SPARC V8 架构的宇航核心处理器型谱序列技术产品，设计并生产了从单核到四核、从 100MIPS 到 3000MIPS 处理能力等系列化宇航处理器芯片技术产品。

公司的人工智能芯片的应用领域包括：航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等；预计于 2020 年完成芯片生产、测试、验证工作，于 2021 年实现收入。人工智能芯片项目已在前期经过了大量的预研和充分的验证，但由于技术发展日新月异，行业技术及产品更新较快，项目存在一定的技术风险；本项目市场总体向好，需求旺盛，但由于行业竞争日益加剧，需求波动较大，项目存在一定的市场风险；此外芯片生产受当前国际环境的影响，在海外市场拓展方面存在一定的不确定因素。

3. 请补充说明你公司是否存在应披露未披露事项以及筹划中的重大事项的最新进展。

公司回复：

公司目前正在筹划非公开发行股份募集资金项目，具体情况详见公司于 2020 年 3 月 9 日披露的相关公告。鉴于公司 2019 年度财务报告的审计意见为保留意见，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的要求，公司需消除保留事项的影响后再继续推进本次非公开发行事项。目前公司正在积极应对关于李小明违规担保的诉讼事项，努力消除该诉讼事项带来的影响。除上述事项外，公司不存在其他应披露未披露事项以及筹划中的重大事项。

4. 请补充说明你公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近 1 个月买卖你公司股票的情况及未来 1 个月是否存在减持计划。若

是，请说明具体内容。

公司回复：

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近 1 个月内未买卖公司股票，未来 1 个月不存在减持计划。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 26 日